

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 30 日召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求，公司 2019 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度（银行为中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行、中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、招商银行股份有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司铜陵分行）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。

公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2019年4月2日